

平成 14 年 6 月 21 日

各 位

新日鐵化学株式会社

## 無接着剤銅張積層板「エスパネックス」について

- 極薄銅グレードの新商品開発 -
- 新規生産ラインの商業運転を開始 -

新日鐵化学株式会社（社長：西恒美）先端材事業部は、回路関連材料事業の主力商品である無接着剤銅張積層板（2層CCL）「商品名：エスパネックス」につきまして、高密度FPC（フレキシブルプリント基板）向けに、9ミクロン、5ミクロンの極薄銅グレードの新商品を開発し、サンプル出荷を開始いたしました。

また、かねてより増強工事を進めてまいりましたキャストینگ設備につきまして、このほど商業運転を開始いたしました。

### 【新商品の開発について】

次世代携帯電話などに使用される、カラー液晶ディスプレイのドライバーICを実装する、30ミクロンレベルのファインピッチCOF（チップ・オン・フィルム）に対応するため、9ミクロン、5ミクロンという極薄銅グレードの「エスパネックス」を開発し、木更津製造所内に月産5万㎡の精密エッチング設備を導入いたしました。この6月よりサンプル供給を開始しており、7月より量産を行う予定です。

「エスパネックス」は銅箔上にポリイミド前駆体溶液を塗布した後、乾燥・硬化するキャストینگ法で生産していますが、今回開発した新商品は、「エスパネックス」本来の特長である、優れた銅箔接着力の信頼性、寸法安定性を損なうことなく、薄型化において優位性があったスパッタ・メッキ法による2層CCLと同等以上のファインピッチ形成を可能としたものです。2層CCLの銅箔層を、特殊な薬品を用いて均一に溶解する精密エッチング法により、これまでキャストینگ法では、最も薄いもので12ミクロンであった銅箔厚みについて、大幅な薄型化を実現いたしました。

### 【新ラインの商業運転開始について】

ここ数年2層CCLは、携帯電話、デジタルビデオカメラ、DVDなどの小型軽量化、高性能化に伴うプリント配線板の高密度実装化に不可欠な材料として、需要が拡大し続けています。特に今年春から携帯電話用途を中心に「エスパネックス」に対する需要が急速に増加していることから、当社では昨年末に木更津製造所内に新たに導入したキャストینگ設備につきまして、6月より商業運転を開始いたしました。

当社の2層CCL「エスパネックス」は、COFなどの微細配線を形成する際に必要な「寸法安定性」「銅箔接着力の信頼性」「耐マイグレーション性」に優れ、2層CCLの分野では事実上の標準材料となっており、現在、需要を牽引している国内向けカラー携帯電話端末向けの液晶駆動ICモジュールや、多層フレキシブル配線板をはじめ、韓国、欧州における携帯電話カラー端末の本格普及に伴い、継続的な需要の拡大が見込まれることから、来年4月までに硬化工程の設備増強などにより300万㎡/年へ生産能力を引き上げる計画です。

今後、中期的には400万㎡～500万㎡/年までの能力増強も視野に入れており、新商品も含めた先端材事業部トータルで約300億円の売上規模を目標としてまいります。

本件に関するお問い合わせは  
新日鐵化学(株) 総務部（広報）  
03 - 5759 - 2741まで